

## Donanım Tasarımını Yeniden Tanımlıyoruz

Girişim Evresi: Erken Aşama  
Sektör: Çip Paketleme  
Çalışan Sayısı: 4  
Çalışma Baş. Tarihi: 21.08.2025

Finans: \$350K  
☑ \$170K

### Gelirlerin Kullanımı:

%60: Seri Üretim  
%10: Pazarlama ve satış  
%30: Operasyonel büyüme

### Ekip:



Emin YÜCEL  
Co-founder CEO  
13 yıl HW&SW  
Experience



Faddale DEMİR  
Co-founder CTO  
10 yıl HW&SW  
Experience



Halil DEMİR  
Software Dev.  
4 Years Soft.  
Experience



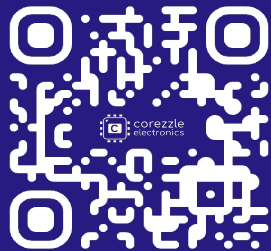
Hilal Nur YÜCEL  
Frontend Dev.  
2 Years Soft.  
Experience



Furkan Dikmen  
Software Dev.  
1 Years Soft.  
Experience

### İletişim:

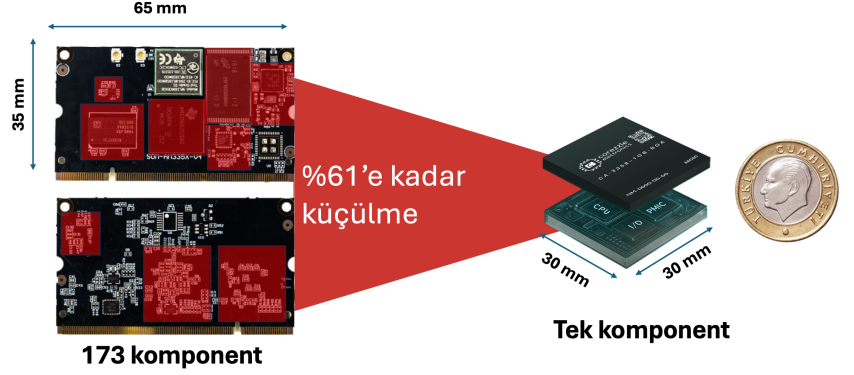
Emin YÜCEL  
Teknopark İstanbul No:1/9C Z09, 34906  
Pendik/İstanbul, Türkiye  
info@corezzle.com, +905416831068



**Corezzle** SiP (Paket içi Sistem) üreticisidir. Elektronik tasarımlarda karmaşıklığı ortadan kaldıran ve süreçleri kolaylaştıran SiP çözümleri üretmektedir.

### Ürün

Corezzle SiP çözümleri birçok farklı bileşeni (mikroişlemci, RAM, güç yönetimi, pasif bileşenler vb.) tek bir paket içinde birleştiren bir teknoloji türüdür. Bu sayede tasarım sürecini basitleştirir, PCB alanından tasarruf sağlar ve geliştirme sürecini hızlandırır.



### Müşteri Problemi:

- Karmaşık Devre Tasarımı: Discrete Design
- Büyük Boyut: 65mm X 35mm
- Arıza Maliyetleri: %3-5
- Prototipleme: 12-24 ay
- Mühendislik: \$60K

### Hedef Pazarı:

Türkiye, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika

### Müşterileri:

- Telemetri firmaları, IoT firmaları, Mobilite sektörü
- Elektronik donanım geliştiricileri
- Akıllı cihaz ve giyilebilir teknolojiler üreticileri
- Savunma ve Uzay Sanayi sektörü

### Satış/Pazarlama Stratejisi:

- Distribütörler ve Çip Satış Platformları (digikeey, mouser vb.)
- Online eğitim ve kullanıcı kılavuzları
- Fuarlar ve sektörel etkinlikler

### İş Modeli:

- Toptan ve perakende satışlar
- Teknik destek ve danışmanlık hizmetleri
- Yazılım entegrasyonu hizmetleri

### Rekabet Avantajı:

- Pazara hızlı çıkış: Günler içinde üretime hazır,
- Yüzde 61 daha küçük boyutlar: "30x30mm",
- Daha Düşük Üretim Maliyeti:
- Azaltılmış Mühendislik Maliyeti,
- Azaltılmış Tedarik Zinciri Maliyeti,
- Arıza Maliyetinin Azaltılması,
- PCB'de gereken katman sayısını %33 ila %50 oranında azaltır

**Rakipler:** Amkor Technology, Nordic Semiconductor, Octavo Systems  
Corezzle rakiplerinden farklı olarak sektör bazlı özelleştirilmiş işletim sistemi (canbus, linbus, profi-net/bus, modbus, gsm ve lora vb. protokoller ) sağlamaktadır.